

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于新增 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。上述议案超出董事会审议的权限范围，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、新增授信情况概述

为满足公司及子公司业务发展及经营需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构新增申请合计不超过人民币 6.5 亿元综合授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，授信方案最终以实际签署的授信合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内综合授信额度可循环使用。

上述公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、本次交易目的和对公司的影响

公司及子公司新增 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，是基于公司及控股子公司 2026 年度的实际业务发展需要，有利于缓解公司及控股子公司的资金压力，有利于公司及控股子公司业务的开展。本次公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司及控股子公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月19日